半導体封止材用エポキシ樹脂・硬化剤・硬化促進剤の種類と特徴および新技術

【LIVE配信】 ~各種エポキシ樹脂・硬化剤・促進剤の特徴と新技術を知り、貴社の課題解決へ~_{【アーカイ}配信】

▶日 時:2026年01月28日(水)10:30~16:30

【アーカイブ配信:1/29~2/12(何度でも受講可能)】

◆会 場:【WEB限定セミナー】※ご自宅や職場でご受講下さい。

◆受講料: 1名につき55,000円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

・1名でお申込みされた場合、1名につき49,500円

2名同時にお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で55,000円)

・ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴いずれも受講料は同じです。

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】 横山技術事務所 代表 工学博士 横山 直樹 氏

【講座趣旨・プログラム】※詳細内容は弊社HPでご確認下さい。

半導体および半導体封止材メーカーの事業企画部門、研究開発部門、生産技術部門、製造部門、技術サービス部門の皆様を対象に、エポキシ樹脂 ・硬化剤・硬化促進剤の基礎から新技術までを詳しく解説いたします。

1. 半導体パッケージと封止材の概要

1-1 半導体パッケージの概要

QFP, SO系, FC-BGA, FO-WLPなど半導体パッケージ種類と市場動向

1-2 半導体封止材の概要

半導体封止材の役割、使用工程、構成材料、成形方法

2. エポキシ樹脂の概要

2-1 エポキシ樹脂の用途と種類 2-2 エポキシ樹脂の製造法

2-3 エポキシ樹脂の分析法

3. 半導体封止材用エポキシ樹脂とその特性

- 3-1 クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 (ECN)
- 3-2 テトラメチルビフェニル型エポキシ樹脂 (TMDGBP)
- 3-3 ビフェニルアラルキル型エポキシ樹脂 (MAR-ER)
- 3-4 ナフトールノボラック or 同アラルキル型エポキシ樹脂 (NAR)
- 3-5 ジシクロペンタジエン (DCPD) 型エポキシ樹脂
- 3-6 トリスフェノールメタン型エポキシ樹脂 (TGMTP)

4. 硬化物の特性評価法と特性解析法

4-1 熱分析

DSC, TMA, TG-DTA

- 4-2 動的粘弾性 (DMA)
- 4-3 力学特性

引張試験、曲げ試験、内部応力、破壊靭性 (K1C)

4-4 電気特性

体積抵抗率-表面抵抗率、(比)誘電率-誘電正接

5. 硬化剤の概要

5-1 硬化剤の種類 5-2 硬化剤の分析法

6. 半導体封止材用硬化剤とその特性

6-1 概要

- 6-2 フェノールノボラック (PN) 系
- 6-3 フェノール-アラルキル (Ph-Ar)
- 6-4 ビフェニル-アラルキル (BPh-Ar)
- 6-5 ナフトールノボラック or 同アラルキル (1-NAR, 2-NAR) 系
- 6-6 Ph, Ph-Ar, 1-NAR, 2-NAR各硬化物の特性比較
- 7. 半導体封止材用硬化促進剤とその特性

7-1 3級アミン類 7-2 イミダゾール類

7-3, トリフェニルホスフィン(TPP)

8. 半導体封止材用改質剤とその特性

8-1 インデン系およびスチレン系樹脂

8-2 クマロン-インデン樹脂

- 9. フィラーの充填率と粒径が半導体封止材特性に及ぼす影響
- 10. FO-WLP用封止材におけるエポキシ樹脂組成物の新技術 - 支持体の反り低減-
- 11. SiC系パワー半導体用封止材向におけるエポキシ樹脂の新技術 -高耐熱劣化性エポキシ樹脂-
- 12. SiC系パワー半導体用絶縁シート向けエポキシ樹脂の新技術 -高熱伝導性エポキシ樹脂-
- 13. まとめ

本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

- 1)Zoomを使用されたことがない方は、こちら(https://zoom.us/download#client_4meeting)からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ブラウザ版でも受講可能です
- 2)セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。はじめかたについてはこちら(https://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf)をご覧ください。
- 3)開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。セミナー開始10分前までにメールに記載されている視聴用URLよりご参加ください。 ・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

『エポキシ樹脂』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒<■LIVE ■アーカイブ>

| 会社·大学 | ;学 | | | | | ●Webセミナーの受講申込みについて 必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下 さい。上記のLIVEかアーカイブにチェックを 入れて下さい。弊社から受付完了のご連絡を | |
|---|----|----|-----|------|-----|--|--|
| 住 所 | 〒 | | | | | | |
| 電話番号 | | | FAX | | | いたしまして請求書をお送りいたします。 セミナーお申込み後、ご都合により出席でき | |
| お名前 | | 所属 | | E-Ma | nil | なくなった場合は代理の方がご出席下さい。 代理の方も見つからない場合、営業日(土日 | |
| 1 | | | | | | 祝日を除く)で8日前まででしたらキャンセル をお受けします。 | |
| 2 | | | | | | 受講料の支払いに関してはHPをご覧下さい。 ⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/entry | |
| 会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。 □Eメール □ 郵送 | | | | | | 個人情報保護方針の詳細はHPをご覧下さい。 ⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy | |



株式会社R&D支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル 7F TEL)03-5857-4811 FAX)03-5857-4812 URL)http://www.rdsc.co.jp/